

平成 30 年 10 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代表者名 代表取締役社長 山村 章
(JASDAQ・コード6890)
問合せ先 取締役経営企画担当 若木 啓男
(03-3281-8186)

半導体ウェーハ事業における中国子会社設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、中国子会社での設備投資の実施について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 設備投資の背景

当社の半導体 200mm ウェーハ事業につきましては、インゴット製造を「寧夏銀和半導体科技有限公司（銀川市）」、ウェーハ加工を「上海申和熱磁電子有限公司（上海市）」の各子会社にて行い、現在月産 10 万枚の生産能力（一次ライン）を有しています。一方、200mm ウェーハの今後の市場動向については、ロジック、メモリー系のみならず、IoT や車載向けセンサー、パワーデバイス向けなどでも旺盛な需要が予測される中で、中国政府は「中国製造 2025」における半導体産業育成政策において、半導体製品の国産化比率の向上を図るべく国内の半導体メーカーの育成支援を積極的に進めております。

当社としましては、2017 年 9 月 15 日付当社リリース「半導体ウェーハ事業における中国杭州市政府との提携並びに新会社設立に関するお知らせ」にあります通り、200mm 半導体ウェーハの月産 35 万枚の二次ラインの生産体制構築の為、中国杭州市との投資協定に基づき、同市大江東開発区に新会社「杭州中芯晶圆科技股份有限公司（杭州市）」を当社グループ 100%子会社として設立し、世界第三位の半導体ウェーハメーカーである Global Wafers Corporation 社の技術協力の下、これまで設備選定、工場建設等の準備をしてまいりました。今般、下記の内容にて設備投資の内容が確定した為、お知らせするものです。

尚、200mm ウェーハ以上に需要拡大が見込まれ、中国での国産化推進の対象となる 300mm ウェーハにつきましては、現在当社の「寧夏銀和半導体科技有限公司（銀川市）」において、インゴットの開発、試作を行っており、今回決議された設備投資には 300mm ウェーハのパイロットライン月産 3 万枚の生産ラインも含まれております。但し、こちらにつきましては、200mm ウェーハ一次、二次ライン合計月産 45 万枚の量産体制が確立されることを前提に、ボトルネックとなる技術的なハードルの解消状況、市場動向、需給ギャップなど鑑みながら、慎重に判断して行く所存であり、現段階では具体的な量産までのスケジュール化には至っておりません。

2. 設備投資の内容

1) 設備投資項目

- ① 200mm ウェーハ二次ライン増設分となる月産 35 万枚体制構築 (約 510 億円)
 - ・ 「寧夏銀和半導体科技有限公司 (銀川市)」でのインゴット製造ライン
 - ・ 「杭州中芯晶圆科技股份有限公司 (杭州市)」でのウェーハ加工ライン
- ② 300mm ウェーハ新設月産 3 万枚パイロットラインの体制構築 (約 160 億円)
 - ・ 「寧夏銀和半導体科技有限公司 (銀川市)」でのインゴット製造ライン
 - ・ 「杭州中芯晶圆科技股份有限公司 (杭州市)」でのウェーハ加工ライン

3) 投資予定額 約 670 億円 (①+②)

※①には、工場土地、建物、ユーティリティを含みます。

4) 資金調達 金融機関からの借入、リース (延払い)、政府補助金、自己資金等を中心に計画

※こちらにつきましても決議次第、開示予定。

3. 稼働予定時期

1) 200mm ウェーハ二次ライン増設分となる月産 35 万枚体制構築

- ・ 工場竣工 2018 年末まで
- ・ 装置試運転開始 2019 年第 2 四半期 (中国子会社暦年ベース) ※2019 年 4-6 月期
- ・ 量産開始 2019 年第 4 四半期 (中国子会社暦年ベース) ※2019 年 10-12 月期
- ・ フル生産体制 2020 年末まで

2) 300mm ウェーハ新設月産 3 万枚パイロットラインの体制構築

- ・ 現時点ではスケジュール等詳細未定 (具体的な展開時期が決まり次第、開示予定)

4. 今後の見通し

- 1) 200mm ウェーハ二次ライン増設分の設備投資額の一部である 240 億円は 2019 年 3 月期の計画に盛り込まれています。
- 2) 本設備投資によって、今後当社の業績に影響を与える際は速やかに開示いたします。

以 上